圧接工法で接合した LSI 内蔵基板の信頼性

谷　元昭 *，石月　義克 *

Reliability of LSI Embedded Substrate Using Pressure Bonding

Motoaki TANI* and Yoshikatsu ISHIZUKI*

* 株式会社富士通研究所（〒 243-0197　神奈川県厚木市森の里若宮 10-1）
*FUJITSU LABORATORIES LTD. (10-1 Morinosato-Wakamiya, Atsugi, Kanagawa 243-0197)